
未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細描述，請參閱本文件「業務 — 我們的策略」。

未來計劃及[編纂]用途

我們估計，假設[編纂]未獲行使，並假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元（即本文件所載[編纂]的中位數），經扣除[編纂]費用及[編纂]以及我們就[編纂]已支付及應支付的估計[編纂]後，我們將收取[編纂]淨額[編纂]港元。

我們擬將[編纂][編纂]用於以下用途：

- [編纂]淨額的約[51]%（或[編纂]港元）預期用於擴充我們光模塊及其他光電互聯產品的產能，並提升我們各產品線的自動化水平。具體而言：
 - (i) 約[17]%的[編纂]淨額（或[編纂]港元）預期用於建設及擴張生產設施。

該等投資預期將使我們實現更大的規模經濟、進一步優化成本結構，並加強供應能力及市場地位。為應對新興需求、新一代產品的量產及持續的技術進步，我們正策略性擴展全球生產佈局，以支持產品組合升級、確保及時交付，並維持長期競爭力。

具體而言，我們計劃投資於(a)在南通建設生產基地，配備高速光模組及其他光電互聯產品的自動化生產線；及(b)在北京建立硅光子封裝技術自動化生產線。

未來計劃及[編纂]用途

- (ii) 約[34]%的[編纂]淨額(或[編纂]港元)預期用於投資設備及生產線。

我們計劃投入先進設備以提升自動化與生產效率，改善產品質量並提高整體良品率。我們亦擬透過採用節能設備及部署智能環境監測及控制系統推進ESG計劃，進一步降低能耗與廢棄物排放。

- 約[37]%的[編纂]淨額(或[編纂]港元)預期用於未來三年內持續投資新產品及技術的研發。具體而言：

- (i) 約[29]%的[編纂]淨額(或[編纂]港元)預期用於挽留現有頂尖研發人才，及從世界一流大學吸引新的頂尖研發人才及專業人士，以進一步加強我們的全球研發能力。其包括用於從事光模塊、硅光子芯片及其他先進光電互聯技術開發的人員的薪酬及激勵計劃開支。

- (ii) 約[8]%的[編纂]淨額(或[編纂]港元)預期用於採購及安裝用於光模塊、硅光子芯片及其他光電互聯產品的專用研發設備。我們計劃開發並測試高速光模塊的尖端技術，包括1.6T及3.2T光模塊、採用NPO及CPO封裝技術的新一代模型，以及整合LRO及LPO信號處理技術的產品。

- 約[2]%的[編纂]淨額(或[編纂]港元)預期用於未來三年內的業務推廣及海外市場拓展。具體而言：

- (i) 約[1.5]%的[編纂]淨額(或[編纂]港元)預期將用於加強我們的國內銷售團隊及網絡，以提高客戶參與度及對客戶需求的響應。

未來計劃及[編纂]用途

- (ii) 約[0.5]%的[編纂]淨額(或[編纂]港元)預期將用於業務推廣及品牌建設活動，包括組織專業論壇及研討會、參加主要行業展覽及實施有針對性的營銷活動，以提升我們的品牌知名度及認知度。

我們相信，該等努力將加深我們與現有客戶的關係，吸引新客戶，並加快我們在國內外市場的市場滲透率。

- 約[10.0]%的[編纂]淨額(或[編纂]港元)預期用於營運資金及一般企業用途。

倘最終釐定的[編纂]高於或低於估計[編纂]的中位數，上述[編纂]分配將按比例作出調整。

倘[編纂]釐定為每股[編纂][編纂]港元(即本文件所載[編纂]的上限)，經扣除[編纂]費用及[編纂]以及我們就[編纂]應付的估計開支後，我們將收取[編纂]淨額約[編纂]港元。

倘[編纂]釐定為每股[編纂][編纂]港元(即本文件所載[編纂]的下限)，經扣除[編纂]費用及[編纂]以及我們就[編纂]應付的估計開支後，我們將收取[編纂]淨額約[編纂]港元。

倘[編纂][編纂]淨額未能及時用於上述用途，或我們未能按預期落實未來發展計劃的任何部分，我們僅會將該等[編纂]淨額存入持牌商業銀行及／或其他獲授權金融機構(定義見證券及期貨條例或其他司法權區的適用法律法規)的短期計息賬戶。倘上述擬定[編纂]用途有任何變動，我們將作出適當公告。